

公司代码：603991

公司简称：至正股份

**深圳市领先半导体科技产业股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已实施2025年三季度利润分配，合计派发现金红利1,527,097.10元（含税）。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-46,599,844.90元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-223,458,383.77元。鉴于公司2025年度亏损且母公司未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》规定，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

**截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响**

适用  不适用

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为人民币-223,458,383.77元，合并报表未分配利润-160,303,085.51元，存在累计未弥补亏损。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟不进行2025年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

## 第二节 公司基本情况

### 1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	至正股份	603991	

联系人和联系	董事会秘书	证券事务代表
--------	-------	--------

方式		
姓名	张斌	杨玥熙
联系地址	深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304	深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304
电话	0755-29618132	0755-29618132
传真	0755-27335548	0755-27335548
电子信箱	ir@sz-lsi.com	ir@sz-lsi.com

## 2、报告期公司主要业务简介

公司目前主营业务为半导体封装材料引线框架与半导体封装专用设备的研发、生产和销售，相关产品主要应用于半导体产业后道先进封装及传统封装测试环节，为芯片封装制程提供核心配套支撑，隶属于半导体产业链关键配套领域。

### （一）半导体行业情况

2025年全球半导体市场摆脱下行周期，实现全面复苏上行。根据 WSTS 数据，2025 年全年市场实绩公告，全年全球半导体市场销售额达 7917 亿美元，同比增长 25.6%。AI 算力爆发、汽车电动化智能化普及、先进封装技术迭代及国产替代加速，成为驱动行业增长的核心动力。国家持续出台产业扶持政策，加大对半导体领域的支持力度，着力破解供应链“卡脖子”难题，为行业内优质企业提供了良好的发展机遇与政策环境。

#### 1、半导体引线框架行业

引线框架作为一种重要和基础性的半导体封装材料，广泛应用于各类半导体产品。随着半导体产业的不断发展，引线框架市场规模保持增长态势。根据 TECHCET、TechSearch International 及 SEMI 联合发布的《全球半导体封装材料展望 2024》权威报告数据，2023-2028 年全球引线框架市场年均复合增长率为 5.6%，预计 2028 年全球引线框架市场规模将达到 47 亿美元，行业整体发展保持稳健增长。

目前全球前五大引线框架供应商中，除 AAMI 外其他四家均为境外上市公司，主要分布在日本、中国香港、韩国、中国台湾等亚洲地区，国际头部厂商掌握了高精密度、高可靠性、高复杂度的高端核心技术，行业市场集中度较高。随着全球半导体封装测试市场向高密度、高脚位、薄型化、小型化方向发展，引线框架行业将持续向高精密度领域拓展，QFN、QFP 和其他中高端 LFCSPP（引脚架构芯片级封装）引线框架将占据更大比重。同时，随着汽车、功率等下游行业强劲需求增长，行业内厂商将不断设计开发新的引线框架以满足散热和可靠性等性能需求。此外，随着芯片技术的不断发展和市场需求的多样化，引线框架供应商需要为客户提供量身定制的差异化解决方案，对研发设计能力和技术创新能力提出了更高要求。在前述多种因素的综合作用下，可见行业头部客户对优良的技术和可靠的质量需求日益增加，引线框架行业集中度可能持续提升。

#### 2、半导体封装设备行业

根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的《2025 年全球半导体设备市场实绩报告》，2025 年全球半导体制造设备销售额达 1,351 亿美元，同比增长 15%；其中封装与组装（A&P）设备销售额同比增长 21%，测试设备同比增长 55%，增长主要受先进逻辑、存储器及 AI 相关产能扩张带动。

### （二）公司的行业地位

公司借助子公司 AAMI 切入半导体封装材料赛道，AAMI 为公司第一大营收与利润贡献主体，专注半导体引线框架领域深耕，拥有先进的生产工艺、高超的技术水平和强大的研发能力，积累了丰富的产品版图、技术储备和客户资源。AAMI 长期稳居全球引线框架行业头部企业，2025 年营收规模持续提升，根据全球主要引线框架厂商的财务报告，按年度平均汇率将 2025 年引线框架收入换算为美元，AAMI 引线框架收入规模排名由 2024 年的全球第四名，跃升至 2025 年的全球第

二名，市场份额持续扩大。全球引线框架行业市场集中度较高，头部厂商占据主导地位，AAMI 凭借长期技术积淀、全球化产能布局、稳定产能交付能力与优质客户资源，深度绑定全球头部 IDM 及专业封测厂商，在高精密度、高可靠性高端应用市场竞争优势突出，产品广泛覆盖汽车、计算、工业、通信及消费类半导体领域，得到各细分领域全球头部客户的高度认可。

### （三）线缆用高分子材料行业情况

公司本次置出的线缆用高分子材料业务，所属行业为高分子改性材料行业下的线缆用材料细分领域，产品主要应用于电力电缆、通信电缆等线缆制品生产，是电线电缆产业链的重要配套环节。该行业处于成熟发展阶段，行业参与主体多元，市场格局相对稳定。截至报告期末，公司已完成该项业务的置出工作，不再从事线缆用高分子材料相关生产经营，聚焦半导体核心主业深耕发展。

#### （一）公司主营业务情况

报告期内，公司完成重大资产重组，置入半导体封装材料引线框架相关业务并置出线缆用高分子材料相关业务。报告期内，公司涉及的主营业务为半导体封装材料业务、半导体专用设备业务及线缆用高分子材料业务。

##### 1、半导体封装材料

报告期内，公司通过子公司 AAMI 开展半导体封装材料业务，AAMI 专业从事半导体引线框架的设计、研发、生产与销售。引线框架是一种重要的半导体封装材料，引线框架的引脚与芯片的焊盘通过键合引线进行连接，将芯片的内部信号引出，引线框架发挥电气连接、机械支撑、热管理等作用，对芯片的电气特性、可靠性、散热性产生直接影响，广泛应用于各类半导体产品。AAMI 的引线框架产品包括冲压和蚀刻两类，其中，（1）冲压引线框架通常适用于常规封装类型产品，如 SOIC、TSSOP 和 SOT 以及中低引脚数 QFP 封装，产量较高、制造成本相对较低，用于满足大批量需求，广泛应用于消费电子产品；（2）蚀刻引线框架主要应用于 QFN/DFN 和高引脚数、细间距 QFP 封装，具有较高精度尺寸控制。其中，QFN/DFN 广泛应用于智能手机、笔记本电脑，先进 QFN 多用于射频设备，具有更小的封装尺寸优势。此外，AAMI 所提供的细间距、高引脚数的 LQFP 产品多应用于汽车市场的 MCU 组件和 HPC（高性能计算）市场。

##### 2、半导体专用设备

公司通过子公司苏州桔云开展半导体专用设备业务，上市公司自 2022 年开始向半导体行业转型，于 2023 年并表了从事半导体专用设备业务的苏州桔云，苏州桔云主要从事半导体后道封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备等。

##### 3、线缆用高分子材料业务

公司通过至正新材料开展线缆用高分子材料业务，定位于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，主营电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。截至报告期末，公司已置出该部分业务，不再从事该业务的生产经营。

#### （二）主要经营模式

##### 1、半导体封装材料业务主要经营模式

AAMI 主要采用“接单生产”的生产模式，销售部门接到客户订单后，物料计划与控制部门结合客户的产品型号、数量和交期需求以及产能利用情况制定生产计划，并下发给各生产部门按工单进行生产。

AAMI 通过直销模式进行产品销售。AAMI 凭借一流的产品质量、良好的业内口碑和优秀的服务与竞争能力和全球优质客户建立了持续稳固的合作关系，主要客户均为全球知名、行业头部的 IDM 和 OSAT 企业，大部分主要客户合作年限超过二十年。AAMI 建立了完善的境内外销售网络和服务体系，以满足客户诉求和集团管理需求。

AAMI 以自主研发为主，研发内容主要包括技术开发和产品开发，研发项目的立项综合考虑市

场部门调研建议和研发部门可行性评估，核心目标为产生收益及提升竞争力。

## 2、半导体专用设备业务主要经营模式

实行订单式定制化生产、主要采用直销模式，与客户确认需求及技术参数并签订协议后，开展定制化设计与生产；直销通过商务谈判、招投标获取订单，公司聚焦研发设计核心环节，核心零部件外购后完成组装测试，再交付客户验收。

## 3、线缆用高分子材料业务主要经营模式

线缆用高分子材料业务采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	5,312,115,320.28	636,018,910.80	735.21	600,749,300.01
归属于上市公司 股东的净资产	3,497,357,470.67	225,808,051.21	1,448.82	256,341,831.83
营业收入	550,290,754.51	364,562,710.36	50.95	239,419,249.63
利润总额	-68,609,002.48	-10,941,679.33	不适用	-34,834,331.62
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	550,259,784.83	359,419,558.34	53.10	239,341,514.66
归属于上市公司 股东的净利润	-46,599,844.90	-30,533,780.62	不适用	-44,423,464.54
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-96,438,873.66	-35,586,802.98	不适用	-58,423,567.27
经营活动产生的 现金流量净额	-14,087,716.90	-26,772,774.77	不适用	-41,860,206.24
加权平均净资产 收益率(%)	-11.72	-12.67	增加0.95个百分 点	-15.95
基本每股收益(元/股)	-0.58	-0.41	不适用	-0.6
稀释每股收益(元/股)	-0.58	-0.41	不适用	-0.6

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	51,190,613.66	52,985,658.62	46,385,902.89	399,728,579.34
归属于上市公司股东的净利润	-14,231,535.00	-8,416,497.74	-6,862,582.73	-17,089,229.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,785,971.09	-8,700,637.98	-7,212,272.42	-65,378,773.16
经营活动产生的现金流量净额	4,646,301.31	6,583,881.05	5,304,884.89	-30,622,784.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4、 股东情况

#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

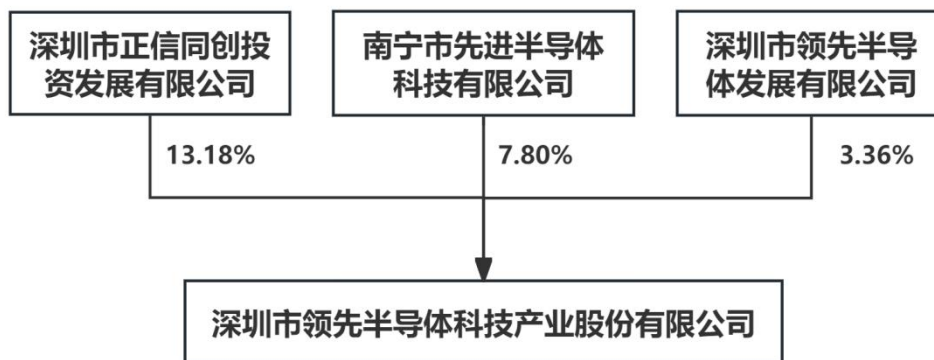
截至报告期末普通股股东总数（户）		10,387					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		9,265					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
先进香港控有 限公司	29,000,000	29,000,000	18.99	29,000,000	无	0	境 外 法 人
深圳市正信同 创投资发展有 限公司	0	20,124,450	13.18	0	质 押	15,000,000	境 内 非 国 有 法 人

南宁市先进半导体科技有限公司	11,915,580	11,915,580	7.80	11,915,580	无	0	境内非国有法人
通富微电子股份有限公司	6,718,750	6,718,750	4.40	6,718,750	无	0	境内非国有法人
深圳市领先半导体发展有限公司	5,137,307	5,137,307	3.36	5,137,307	无	0	境内非国有法人
马杰	4,050,405	4,050,405	2.65	4,050,405	无	0	境内自然人
伍杰	2,343,750	2,343,750	1.53	2,343,750	无	0	境内自然人
陈永阳	1,875,000	1,875,000	1.23	1,875,000	无	0	境内自然人
三亚泓谦企业管理咨询中心（有限合伙）	1,800,180	1,800,180	1.18	1,800,180	无	0	境内非国有法人
张燕	1,750,000	1,750,000	1.15	1,750,000	无	0	境

							内 自 然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体科技有限公司为公司控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司的一致行动人，三方共同受实际控制人王强控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

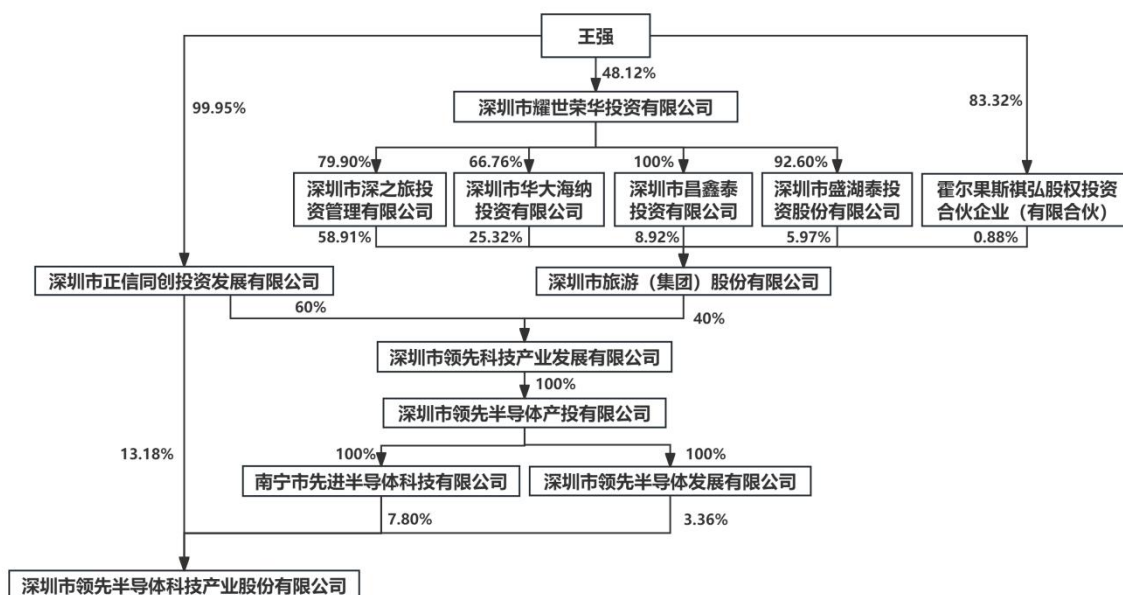
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告第三节“三、经营情况讨论与分析”。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用